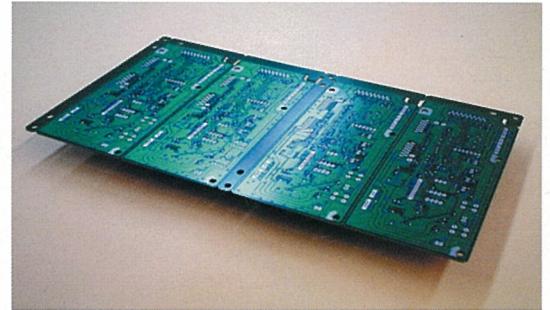


銀スルーホールプリント配線板

表裏の回路導体との電気的接続を、
低マイグレーション導電ペーストの導入により、
高信頼性・高密度化対応の配線板です。

特徴

スルーホール内に銀ペーストを埋め込んで表裏の回路を接続した両面プリント配線板。
コストパフォーマンスに優れ、主に民生用機器で両面めっきスルーホール配線板ではコスト面が厳しく、片面プリント配線板では集積が難しい製品（例えば、TV、FAX、電話、オーディオ、プリンター等）に使用されます。



主な電気的特性

一般特性仕様

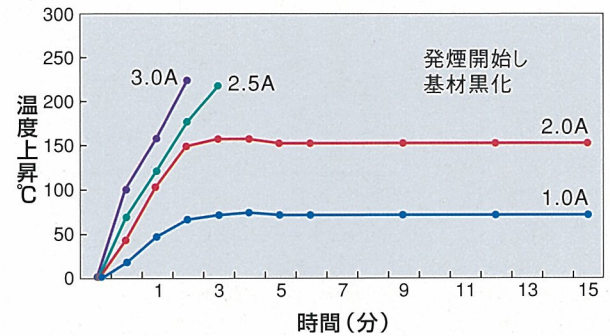
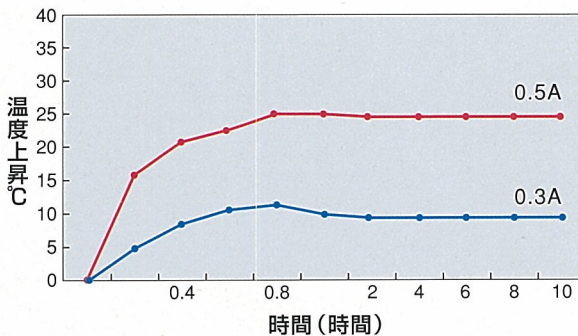
(1) 抵抗値	100mΩ以下/穴
(2) 電圧	DC50V以下
(3) 絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC100V印加)

許容電流仕様

最大許容電流値	ラッシュ電流値
300mA以下/1穴	1.0A

*ラッシュ電流:装置の数回の電源ON/OFF時に生ずる過電流をいう

通電電流とスルーホール近傍の温度上昇



試験試料: 紙フェノール基材 1.6t
スルーホール径 φ0.45
スルーピッチ 1.5mm

株式会社 京写 Kyosha Co.,Ltd.

<http://www.kyosha.co.jp> E-mail:sales@kyosha.co.jp

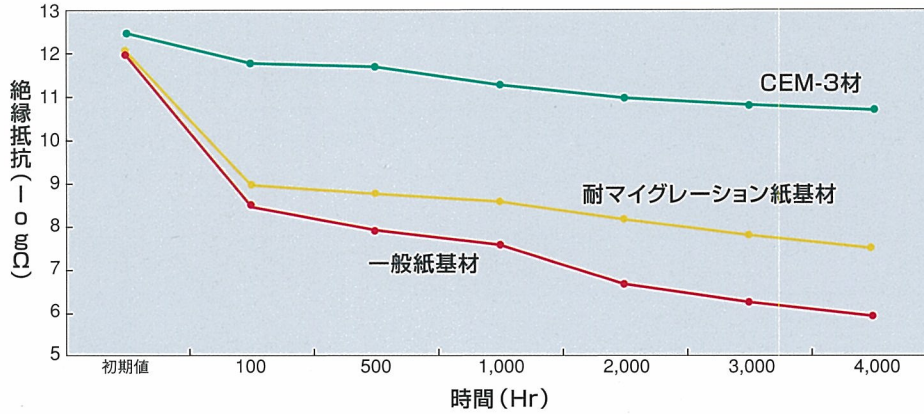
お問合せ先

本社 〒613-0024 京都府久世郡久御山町森300
関東支社 〒111-0041 東京都台東区元浅草1-6-13 元浅草MNビル3階

TEL 075-631-3191 FAX 075-631-7761
TEL 03-3842-5071 FAX 03-3842-5072

絶縁性能 <評価試験の例>

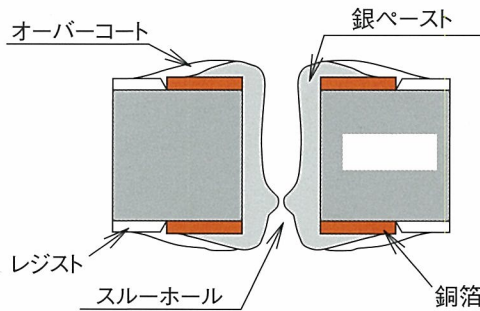
基材別絶縁特性



条件 銀導体間隔=0.3mm
印加電圧=DC50V
温湿度=40°C×90~95%

銀スルーホールの設計基準

No.	最小ピッチ	スルーホール下穴径	ランド径	ランド間隔	銀パッド径	レジスト径	オーバーコート径
1	2.0mm	φ0.65	φ1.5/0.5 (外形/内径)	0.5mm (銀印刷面)	φ1.1	φ1.8	φ2.1/0.7 (外形/内径)
2	1.5mm	φ0.45	φ1.2/0.3 (外形/内径)	0.3mm (銀印刷面)	φ0.8	φ1.5	φ1.8/0.6 (外形/内径)



スルーホール信頼性

- (1) 銅スルーと銀スルーとの比較
銀ペーストは接続耐久性が大きい
- (2) 銀スルーの試験性能

試験項目	条件	抵抗変化率 %
はんだ耐熱	5秒・5回	+100/-50%以下
熱衝撃	500サイクル	+100/-50%以下
ホットオイル	100サイクル	+100/-50%以下
煮沸	2Hr・4回	+100/-50%以下

